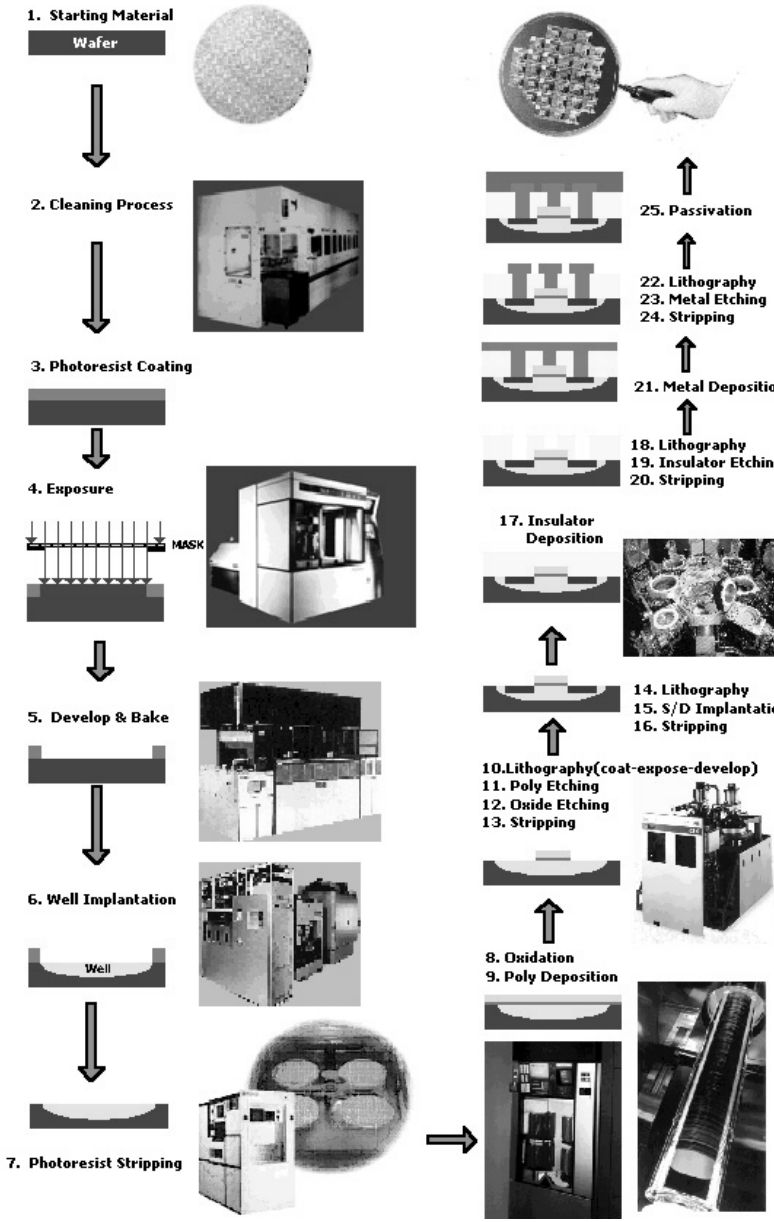
ผลิตแผ่นวงจรรวมในไทย

ดำเนินการผลิตวงจรรวมเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม สร้างวงจรรวมต้นแบบและฝึกอบรมบุคลากรภายในประเทศ

ลักษณะการดำเนินงาน

- บริการผลิตแผ่นวงจรรวม (Wafer Fabrication) จำนวนน้อย
- บริการทำวงจรรวมต้นแบบสำหรับงานวิจัย
- บริการฝึกอบรมสำหรับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

แผ่นวงจรรวมหรือแผ่นเวเฟอร์แต่ละแผ่น ที่ได้จากศูนย์วิจัยฯ ประกอบด้วยชิปเล็กๆ จำนวนมาก ถูกส่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ตัดแยกชิปและประกอบเป็นตัวไอซี เพื่อนำไปใช้งานต่อไป



▲ *เครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจร รวมรูปเครื่องจักร และขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรรวม (Wafer Fabrication)*

โดยทั่วไป ชิป 1 ชิ้น ประกอบเป็นตัวไอซี 1 ตัว ไอซีที่ประกอบขึ้นจะมีรูปลักษณ์ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวงจรรวมที่ถูกออกแบบและการนำไปใช้งาน

▲ *แผ่นวงจรรวมที่นำตัดประกอบเป็นตัวไอซี (IC Packing)*

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์
- ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการผลิตครบวงจร
- สร้างความได้เปรียบในตลาดโลก
- ลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- เพิ่มการจ้างงานในประเทศมากกว่า 60,000 คนและพัฒนาบุคลากร
- ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศเกือบ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลาเพียง 10 ปี

◀ *อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังดำเนินงานก่อสร้างที่จังหวัดฉะเชิงเทรา*

ดำเนินการโดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 250

รหัสผลงาน: BS301-43

ติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร. (662) 644-8150..99 ต่อ 610, 656..9
โทรสาร (662) 644-8122, 644-8137..8